

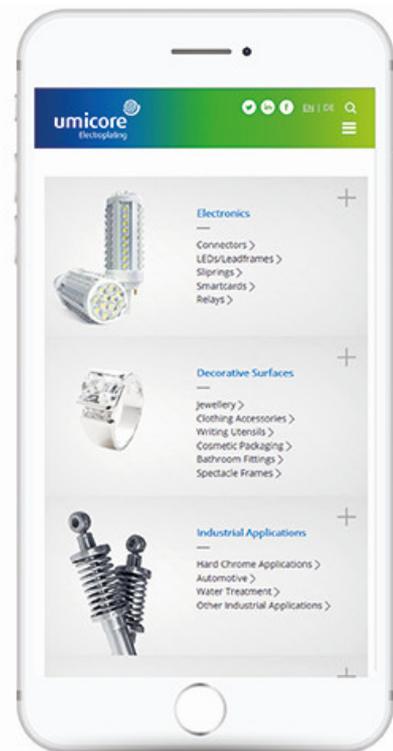
Thru-cup® EVF-N Kupfer Via-Fill-Electrolyt

Additive für sauer Kupfer-via-filling

Thru-cup® EVF-N ist ein neues Additivsystem für die elektrolytische Kupferbeschichtung von Leiterplatten. Es wird im Panel- und im Pattern-Plating von Sacklöchern und gleichzeitigem Durchkontaktieren von Bohrungen eingesetzt. Die Füllgrade der Sacklochbohrungen mit Durchmessern unter 150 µm sind hervorragend. Thru-Cup® EVF-N arbeitet mit drei Additiven, die einfach über CVS analysiert werden können. Die Charakteristik des Füllgrads wird durch die Elektrolytalterung nicht beeinflusst. Die abgeschiedene Kupferschicht weist eine ausgezeichnete Dickenverteilung auf.

Anwendungsmerkmale

- Verbesserung des Wärmemanagements
- Für HDI-Leiterplatten
- Langfristige Zuverlässigkeit der Bestückungs- und Packagingverfahren



Elektrolytcharakteristik

Elektrolyttyp	Saurer galvanischer Elektrolyt
Metallgehalt	200 g/l CuSO ₄ ·5H ₂ O
pH-Wert	sauer
Temperatur	25 (22 - 27) °C
Stromdichte	1,0 (0,5 - 2,5) A/dm ²
Anodenmaterial	Löslich / unlöslich

Vorteile

- Hervorragende Fülleigenschaften von Sacklochbohrungen
- Geeignet für das Panel- und Pattern-Plating bei gleichzeitiger Durchkontaktierung von Bohrungen
- Lange Elektrolytlebensdauer

- Hervorragende Dickenverteilung der plattierten Kupferschicht
- Die Konzentrationen aller Additive können mittels Zyklovoltammetrie (CVS) analysiert werden

Anwendungen

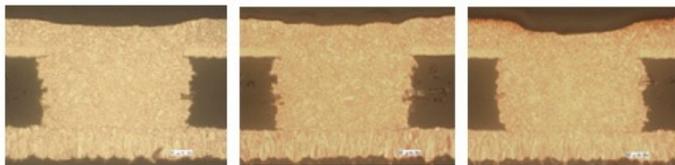
- IT-Produkte
- Unterhaltungselektronik
- Automobilanwendungen

Benötigte Additive und optionale Produkte

- EVF-2A-10X
- EVF-2B-2X
- EVF-N

Querschliffe nach Thru-cup® EVF-N-Abscheidung

Schichtdicke: 20 µm
 Sacklochabmessungen: Durchmesser 125 µm
 Tiefe 85 µm

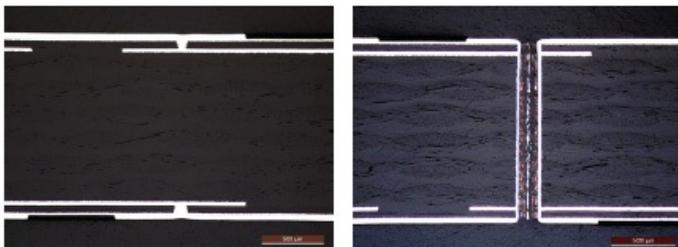


1,5 A/dm²

2,0 A/dm²

2,5 A/dm²

Sackloch-Füllung mit geringem Dimple und gleichzeitiger Durchkontaktierung mit hoher Streufähigkeit



Ihr Ansprechpartner



Andrea Grau
 Leiterin Vertrieb Europa
 T: +49 7171 607 229

